JP 55-3834

1/19/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2007 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0001909230

WPI ACC NO: 1980-14114C/198008

Gallium indium nitride light emitting device mfr. - where beryllium sulphide, zinc oxide, boron phosphide or gallium nitride layer is deposited on substrate

Patent Assignee: SUMITOMO ELECTRIC IND CO (SUME)

Patent Family (2 patents, 1 countries)

Patent Application

 Number
 Kind
 Date
 Number
 Kind
 Date
 Update

 JP 1980003834
 B 19800126
 JP 197220053
 A 19720226
 198008
 B

 JP 49019782
 A 19740221
 198008
 E

Alerting Abstract JP B

BeS, ZnO, BP or GaN layer is deposited on a quartz substrate, an SnO2-coated quartz substrate, a BP(111) substrate, a BAs(111) substrate, a GaP(111) substrate, an alpha-SiC (0001) substrate, SnO (0001) substrate, or sapphire (0001) substrate. An active layer of Ga1-xInxN mixed crystal is formed on the deposited layer.

Title Terms /Index Terms/Additional Words: GALLIUM; INDIUM; NITRIDE; LIGHT; EMIT; DEVICE; MANUFACTURE; BERYLLIUM; SULPHIDE; ZINC; OXIDE; BORON; PHOSPHIDE; LAYER; DEPOSIT; SUBSTRATE

Class Codes

(Additional/Secondary): H01L-021/20, H01L-033/00

File Segment: CPI; EPI

DWPI Class: E32; L03; U11; U12

Manual Codes (CPI/A-M): E31-H04; L03-D04B

Chemical Indexing

Chemical Fragment Codes (M3):

01 M902 A331 A349 A381 A940 C107 C520 C730 C801 C802 C803 C804 C806 C807

M411 M720 N000 Q334 Q451 Q454 R043

02 M903 A300 A331 A349 A381 A940 A990 C107 C520 C730 C801 C802 C803 C804 C806 C807 M411 M720 N000 Q334 Q451 Q454 R043

Original Publication Data by Authority

Japan

Publication No. JP 49019782 A (Update 198008 E)

Publication Date: 19740221

Language: JA

Publication No. JP 1980003834 B (Update 198008 B)

Publication Date: 19800126

Assignee: SUMITOMO ELECTRIC IND CO (SUME)

Language: JA

Application: JP 197220053 A 19720226 Original IPC: H01L-21/20 H01L-33/00 Current IPC: H01L-21/20 H01L-33/00

?

12 特 許 载 (B2) 公 昭55-3834

(1) Int.Cl.3

識別記号

庁内整理番号

244公告 昭和55年(1980) 1 月26日

H 01 L 33/00 21/205

7377-5 F 7739-5 F

発明の数 2

(全5頁)

匈Ga_{1-x}In_xN発光素子の製法

21)特

願 昭47-20053

②出

願 昭47(1972)2月26日

公

開 昭49-19782

④昭49(1974)2月21日

明 者 新宮秀夫 (72)発

京都市左京区松ケ崎小脇町 28

720発 明 者 大槻徴

祥風荘

明 者 長村光造 (72)発

京都市右京区嵯峨野秋街道町 16

70発 明 者 赤井慎一

電気工業株式会社大阪製作所内

切出 願 人 住友電気工業株式会社

大阪市東区北浜5の15

個代 理 人 弁理士 上代哲司

69引用文献

米国特許 3560275 (USA) (クラス 148-171)

電子材料 昭 46.12 第 21 ~ 29 頁

Applied Physics Letters 9(12) 1966. 12. 15 第 441 ~ 444 頁

の特許請求の範囲

1 石英ガラス基板、SnO₂をコーテイングした 石英ガラス基板、Bp111基板、BAs111 基板、GaP111基板、α-SiC0001基 面上に成長させたBeS,ZnO,Bp、又は GaNの成長層から成る基板、およびBeS若し くはBeSeから成るグループから選ばれた一種 の基板上に、動作層としてGa_{1-x}In_xN混晶の 層を気相成長せしめることを特徴とする Ga_{1-x} 35 但しMは金属、i は高抵抗 Ga_{1-x} In_{x} N Y VInxN発光素子の製法。

2 p型のBp若しくはBAs又は高抵抗のBeS

若しくはBeSeから成る基板上に動作層としてn 型Gal-xInxN混晶の層を気相成長せしめるこ とを特徴とするGa_{1-x}In_xN発光素子の製法。 但し、xは0と1の間の値である。

2

5 発明の詳細な説明

本発明はGaNとInNの混晶、すなわちGaı -xInxN(0<x<1)を用いた可視光発光素子 に関するものである。

ⅡーⅤ族化合物半導体を用いた発光素子として 京都市左京区田中東春菜町23の1 10 はGaAs_{1-x}P_x(0 < x < 1)、Ga_{1-x}Aℓ_x As (0 < x < 1), $Ga_{1-x} In_{x} P(0 < x < 1)$, GaP, $Ga_{1-x}A\ell_{x}P(0 < x < 1)$, In_{1-x} AℓxP(0 < x < 1) 等を用いた発光素子がある が、いずれも赤色、黄色、黄緑色の発光素子しか 大阪市此花区恩貴島南之町60住友 15 得られていない。又梁緑色から青色(又は紫色) の発光素子としては GaNを用いた発光素子が提 案されている。しかしながらGaNの禁制帯幅は 300°Kで3.39eVもあり、光でいえば紫外 光に相当する。従つて GaN を用いて可視光を得 20 るには適当な不純物準位を介する電子の遷移を用 いることが不可欠となる。この場合、適当な不純 物が存在するかどうかは明らかでなかつた。

> 本発明はGa_{1-x}In_xN(0<x< 1) の均一 な混晶が形成され得ることを明らかにするととも 25 に、Ga_{1-x}In_xNを用いた優れた可視光発光素 子の製法を提供するものである。

本発明の第1の発明は、電気的にバイアスをか けたときに可視光を発する発光素子の製法におい て、適切な基板上に動作層としてGa1-xInxN 板、Zn00001基板およびサフアイヤ 0001 30 混晶の層を気相成長せしめることを特徴としてい る。ここで、Ga1-xInxN混晶の層をpn接合 を含む層とすることができる。又 n型Ga1-xInx N混晶の層を含む Min 構造をもつ層を動作層と することが出来る。

絶縁物の層を意味する。

本発明において、適切な基板としては、石英ガ

· 3

ラス基板、SnO2をコーテイングした石英ガラス 基板、ΒΡ111基板、BAs111基板、α-SiC0001基板、ZnO0001基板、又は サフアイヤ0001面上に成長させたBeS, ZnO, BP若しくはGaNの成長層から成る基板から選択 5 Gao.4Ino.6N(Zn)では2eV以下のエネルギ することができる。

更に、n型Ga_{1-x}In_xNとのヘテロ接合を pn接合として活用するために、適切な基板とし てp型のBP若しくはBAsを用いたり、又、高 抵抗のBeS若しくはBeSeを基板としてn型 Ga_{1-x} InxNとのni接合を利用することがで きる。

以下本発明を実施例により説明する。

実施例 1:

させて、石英ガラス基板上にGa_{1-x}In_xNの層 を成長させたものである。 GaN と InN の割合 を変化させることによつてxの値が変化させられ た。成長したGa_{1-x}In_xNの層はウルツ鉱型の 結晶構造をもち、石英ガラス基板の面に垂直な方 20 実施例(2: 向に、結晶の<0001>方向が配向する傾向が あつた。この成長のメカニズムはいわゆるレオタ キシャル成長によるものと考えられる。

 $Ga_{1-x}In_{x}N$ の層の厚さは5~10 μ であつ た。

次にX線回折により結晶の格子定数を測定し、 又光の吸収を測定することにより直接型の禁制帯 幅を測定した。

第1図はその測定結果をまとめたものである。 を、縦軸に禁制帯幅 Eg(eV) と格子定数 a(A)お よび c(A)とを示す。

X線回折の実験により、Ga_{1-x}In_xN混晶の 均一な層が成長していることが分つた。又光の吸 収の実験から Ga_{1-x}In_xN混晶が直接遷移型の 35 半導体であることが分つた。

第1図から明らかなような Ga_{1 — x} I n _x N 混晶 においては、格子定数がxとともに直線的に変化 し、いわゆるヴェガードの法則が成立することが 呈し、 CaN と InNのEgを単純に直線で引い たのではGa1-xInxN混晶のEgの値を推定で きないことを意味している。

次にZn,Cd,Mg,Be,Ge,Cuの様な不純物

をトープすると禁制帯幅に相当するエネルギーの 他に別の吸収帯が観測される。第1図の図印は ZnをドープしたGa_{1-x}InxN混晶に観測され る附加的な光吸収のエネルギーを示す。例えば - の吸収が見られ、これは赤色発光用材料として も有用なことを示している。

もし Zn,Cdなどの不純物をドープしないとき は、石英ガラス基板上に成長させたGai-xInxN 10 混晶は n 型半導体であり、300°Kで1~1000 ohm·cmの比電気抵抗を示す。第2図は比較的高 抵抗のn型 Gaı—xInxN 混晶の層に電極を設け た実験を示すもので、図において、1は石英ガラ ス基板、2はGa_{1-x}In_xNの層、3はIn の蒸 本実施例は、GaN結晶とInN結晶とを昇華 15 着膜、4はAuの微小電極である。電極4を正に バイアスしたとき、電極4の近傍で弱い発光が認 められた。(図でh v として発光を示す)。発光 強度は弱いけれども例えば Gao.e Ino.4 N で青色 の発光が観測されたことは興味深い。

本実施例はSnO2の導電層をコーテイングした 石英ガラス基板上に Ga_{I一x}In_xNの層を成長さ せたものである。

第3図は本実施例により作成された発光ダイオ 25 ードの構造を示し、1は石英板、5は導電層、2 はGa_{1-x}InxNの層でn型半導体である。3と 4は電極である。

6は活性窒素中でZnを拡散させたp型Ga₁xInxNの層であるn型Ga1-xInxNの層2の 図は横軸にGa_{1-x}In_xN中のInNのモル比x 30 厚さは5~10 μ、p型Ga_{1-x}In_xNの層**6**の 厚さは $1\sim 2~\mu$ であり、p層6の比電気抵抗は 10³~10⁶ ohm-cm であつた。電極 4 をプラス にしてバイアスを加えた所、層6から肉眼ではつ きり認められる発光が観測された。

> 発光色は x の大きい所(x ~ 0.6) で赤から黄 色 x の小さい所(x ≤ 0.3)で黄緑から深緑色に わたつていた。

実施例 3:

本実施例では単結晶基板が用いられた。 BP, 分る。一方禁制帯幅 Egは x に対し凹型の曲線を 40 BAsの111面、GaPの111面、αーSiC の0001面、 ZnOの0001面等が用いられ た。又サフアイヤ(A ℓ 2 O 3) 上にエピタキシャ ル成長させたBeS,ZnO,BP,GaN 等を基板と して、更にその上に $Ga_{1-x}In_{x}N$ の層を成長さ 5

せることも可能である。

第4図はこの様なGal-xInxNの層の一例で あり、7はサフアイヤの0001面をもつ基板、 8はn型の 2nO のエピタキシャル層、そして2 はn型のGa, _vInxNのエピタキシャル層であ 5 レーザー作用を有する高効率発光素子も可能とな

このウェハに更に高抵抗のGa_{1-x}In_xN又は p型のGa_{1-x}In_xNを成長させれば、容易にい ろいろな発光素子用材料が得られる。その構造の 1 例を第5図に示す。第3図、第4図と同一符号 10 N混晶の層を気相成長せしめることを可能にする は同じものを示す。第5図で電極3,4の間にバ イアスをかければ、高抵抗又はp型のGa1-xInx Nの層6の部分で発光が観測される。この場合、 層 2 の中の x の値よりも層 6 の中の x の値を小さ くするととによつて、外部へ光を取り出し易くす 15 子の分野の発展に寄与するものである。 ることも可能である。

以上の実施例では、発光に寄与する動作層が Ga1-xInxN混晶の層そのものである場合につ いて説明したが、他の半導体とのヘテロ接合を含 む層を動作層とする発光素子を作ることもできる。20 図で、第4図は第5図に示す発光素子に用いられ 例えばp型のBPや BAs 又は高抵抗の Be Se と、n型のGa_{1-x}In_xNとのヘテロ接合を用い れば格子定数の不適合の少い発光素子が得られる。 この様な構造の発光素子は特に深緑から青色(又 は紫色)にまたがる可視光の発光素子として有用 25 7はサファイヤ単結晶基板、8は 2nO のエピタ である。更に複数個の発光素子を用いることによ

り、数字や文字等の表示装置を形成することが出 来る。

又Ga_{1-x}In_xN混晶を用いた発光素子の効率 が向上すれば、緑色から青色(又は紫色)までの るであろう。

以上述べた如く、本発明は、電気的にパイアス をかけたときに可視光を発する発光素子の製法に おいて、適切な基板上に動作層としてGa1-xInx もので、従来のGaP, GaAs_{1-x}P_x, In₁-x AℓxPなどの半導体では得られなかつた深緑色か ら青色の発光素子の製作を可能にし、深緑色から 青色までの各種表示素子を含む新しい光半導体素

図面の簡単な説明

第1図はGa_{1-x}In_xN(0<x<1)混晶の 禁制帯幅と、格子定数の変化を示す図で、第2図、 第3図および第5図は本発明の実施例を示す断面 たGai-xIn xN の層を示す図である。

図において、1は石英基板、2はn型Ga_{1-x} InxNの層、3は陰極、4は陽極、5は透明な導 電層、6は高抵抗又はp型のGal-xInxNの層、 キシャル層である。





